

武汉金运激光股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

- 1、公司拟向银行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度。
- 2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
- 3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
- 4、公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

截止2016年4月21日，公司累计授信和借款金额为人民币11,423.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.95%。

董事会同意申请不超过人民币8,000万元授信额度后，公司累计授信额度将为人民币19,423.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为69.92%。此次新增授信额度是因为去年授信即将到期，截止至目前为止，公司实际累计使用贷款金额为人民币6950万元。

本次申请银行授信额度事项需提交公司2015年度股东大会审议。

武汉金运激光股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日